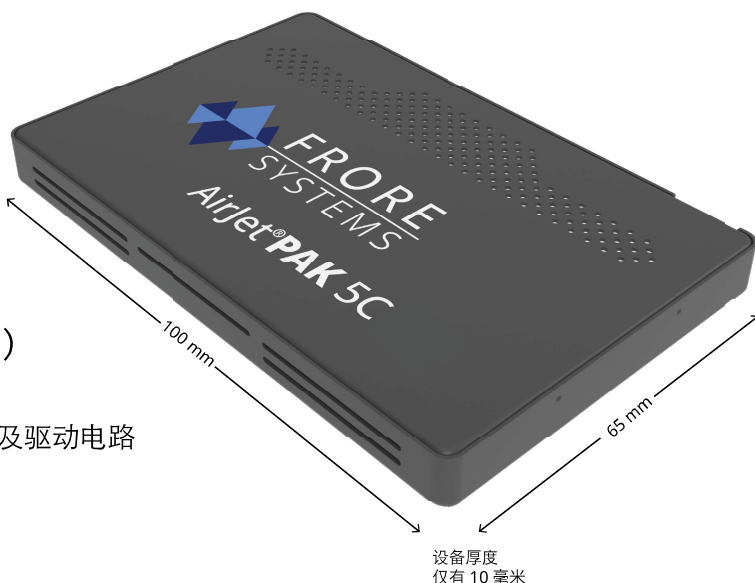




AirJet®PAK 5C

专为 NVIDIA Jetson Orin 等 AI SoM（系统模块）打造，旨在释放极致 AI 性能。

- 全集成、即插即用型散热解决方案，内置多颗 AirJet 芯片及驱动电路
- 直接安装于英伟达 Jetson Orin 等 SoM 模组之上
- 自主运行
- 轻薄、静音、无振动、防尘且防溅水
- 助力 NVIDIA Jetson Orin 实现高达 100 TOPS 的算力
- 在 25℃ 环境温度、结温 (Tj) 为 115℃ 时，净散热净功率可达 34W



散热是计算领域最大的瓶颈，但散热却是现代计算中唯一仍沿用百年前技术的环节。AI 所需的大规模运算对散热性能的要求正快速提升，而据预测，到 2030 年边缘 AI 的需求将增长 300% 以上，这一趋势短期内不会放缓。

AirJet PAK 是全球首款面向边缘 AI 的固态主动散热方案，其核心是革命性的 AirJet 主动散热芯片。AirJet PAK 5C 是一款完全独立的主动散热模块。

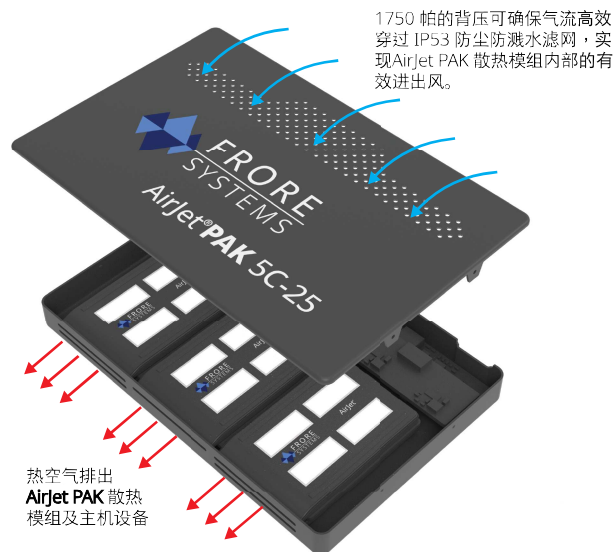
强劲散热能力- AirJet PAK 5C 在 29 dBA 的静音状态下，可实现 34 W 净散热，最大功耗仅 6.5 W，在 25℃ 环境温度下集成至工业计算平台时，其散热能力可使均热板温度控制在 90℃，在紧凑型边缘 AI 设备中性能表现优于风扇方案。

释放 AI 性能 - AirJet PAK 5C 专为与英伟达 Jetson Orin 等人工智能系统级模块（AI SoM）无缝适配而设计，厚度仅为 10 毫米。这一超薄形态为制造商开辟了全新可能，在更紧凑、静音、无振动、防尘且防溅水的设备中，为客户提供更高性能。

NVIDIA Jetson	AirJet PAK	TOPS	Power
Orin NX 16GB (@ 环境温度 25℃ 结温 95℃)	AirJet PAK 5C	100	27 W
AGX Orin 64 GB (@ 环境温度 25℃ 结温 95℃)	2x AirJet PAK 5C	250	54 W

每个 AirJet PAK 5C 内置 5 枚 AirJet 芯片 - 全球首款固态主动散热芯片。

参数	AirJet®PAK 5C
总净散热功率 (@ 环境温度 25℃, 结温 115℃)	34 W
最大噪音 (50cm 距离)	29 dBA
最大功耗	6.5 W
输入电压	12 V
背压	1750 Pa
尺寸 (宽 x 长 x 厚)	100 x 65 x 10 mm
重量	101 g



AirJet® PAK 5C

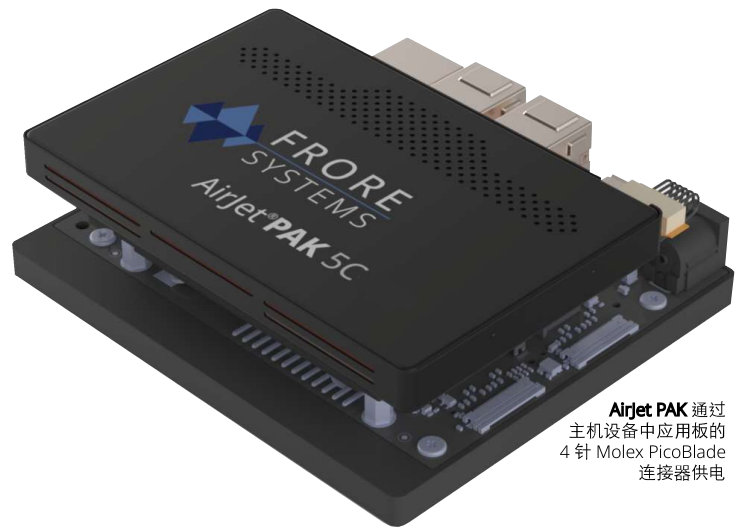
持续性能与可靠性

AirJet PAK 可产生 1750 Pa 背压，即使通风口覆盖 IP53 防尘防溅水滤网，也能确保气流有效进出模块。这一设计最大化了可靠性，保障 AirJet PAK 的持续散热性能，进而实现防尘防溅水设备的持续高性能运行。

AirJet PAK 采用自主驱动，仅需主机设备提供标准电源，即可助力处理器实现卓越性能。

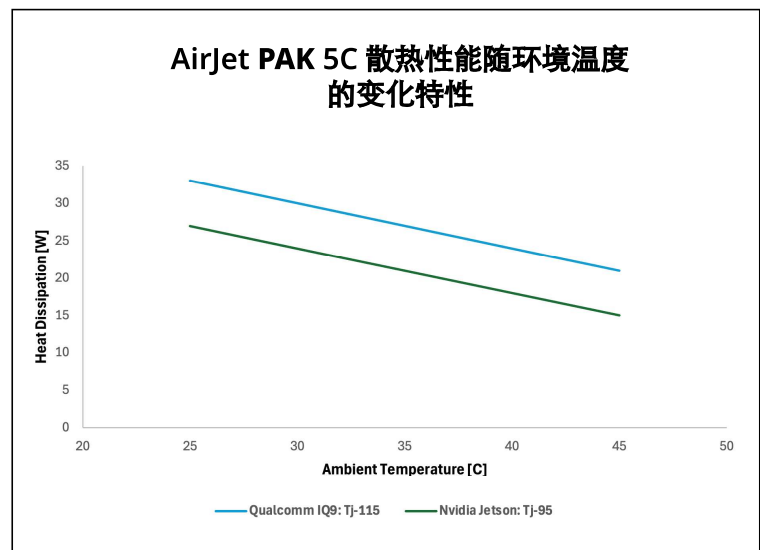
在如今的设备中，决定性能的往往是散热方案的能力，而非仅依赖处理器的先进性。

借助 AirJet PAK 5C，紧凑型边缘 AI 电子设备如今可兑现尖端 AI 技术的性能承诺。**实现更多。**



AirJet PAK 通过主机设备中应用板的 4 针 Molex PicoBlade 连接器供电

专为与英伟达 Jetson Orin Industrial 及智能城市模块等人工智能系统级模块 (AI SoM) 实现无缝适配而设计。



AirJet PAK 模块在主机设备内的横截面

